

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-015

南通富士通微电子股份有限公司 公开发行股票预案

二〇一〇年三月

声 明

1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、南通富士通微电子股份有限公司本次公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特 别 提 示

1、本次发行数量和规模：不超过10,000万股（含10,000万股），募集资金额不超过100,000万元人民币（含100,000万元人民币）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、本次发行股票定价方式和发行价格：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。

3、本次公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。

第一节 本次公开发行概要

一、本次公开发行的背景和目的

（一）本次公开发行背景

在全球经济逐步复苏的带动下，各家机构普遍预测全球半导体市场将在2010和2011年强劲复苏。国内集成电路市场也将迎来新机遇，并以高于全球增幅的速度进一步增长。对于2010年来讲，将必定会成为市场复苏的一年，2010年市场在2009年基础上实现超过15%的增幅并不困难。

具体到2010年的中国集成电路产业，在全球半导体产业复苏与国内内需市场继续保持旺盛的双重带动下，中国集成电路产业将实现较大幅度的增长。预计2010年中国集成电路产业销售额增幅将达到15.1%，规模将基本恢复到2008年的水平。而从中长期来看，随着未来国内外市场的进一步回暖，中国集成电路产业又将步入一轮新的增长周期。

在上述大背景下，中国集成电路产业未来的发展还有诸多亮点：物联网、新能源和节能减排、智能电网、光伏产业、移动多媒体广播技术（CMMB）、“三网融合”、国际产能转移、无线技术及其应用等新兴市场和机遇以及低碳经济概念的兴起，将持续推动市场发展；智能手机、笔记本电脑、液晶电视、电子书、智能表、监控和医疗电子产品等将成为市场发展的热点产品。

上述行业发展趋势为公司今后的业务发展提供了广阔的空间和机会。

（二）本次公开发行目的

公司本次公开发行股票募集资金主要投资于集成电路封装测试二期扩建工程技术改造项目和集成电路封装测试三期工程技术改造项目。

本次发行将帮助公司实现下列目的：

- 1、提升产品档次
- 2、提高公司抗风险能力和竞争能力

二、关于公司符合公开发行股票条件的情况

为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，公司拟以向社

会公开发行股票的方式募集资金（下称“本次发行”）。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司符合公开发行股票的条件，具体说明如下：

（一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司治理的如下要求：

1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；

2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过深圳证券交易所的公开谴责；

4、公司与控股东南通华达微电子集团有限公司及其实际控制人石明达的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

（二）公司盈利能力具有可持续性，符合《上市公司证券发行管理办法》关于公司盈利能力的如下要求：

1、公司最近三个会计年度连续盈利；

2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股东南通华达微电子集团有限公司及其实际控制人石明达的情形；

3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，集成电路封装测试行业市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；

4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；

5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，

不存在现实或可预见的重大不利变化；

6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7、公司最近二十四个月内未曾公开发行证券，因此不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

(三) 公司财务状况良好，符合《上市公司证券发行管理办法》关于财务状况的要求：

1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

3、资产质量良好，不存在对公司财务状况造成重大不利影响的不良资产；

4、经营成果真实，现金流量正常，营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；

5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(四) 公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

(五) 公司募集资金的数额和使用符合如下规定：

1、公司本次增发募集资金数额不超过项目需要量，用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

2、公司本次增发股票募集资金拟投资项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，以及借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、公司本次增发股票拟投资项目实施后，不会影响公司生产经营的独立性；

4、公司已经建立了募集资金专项存储及使用管理制度，历次募集资金均存放于公司董事会决定的专项账户。

(六) 公司不存在下列任一情形：

1、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

2、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

3、公司及控股股东南通华达微电子集团有限公司及其实际控制人石明达最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；

4、公司或公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

5、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

(七) 公司符合以下条件：

1、公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）平均高于6%；

2、公司最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

因此，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行股票的规定，具备公开发行股票的条件，同意公司申请公开发行股票。

三、具体发行方案

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

2、发行股票每股面值：人民币1元。

3、本次发行数量和规模：不超过10,000万股（含10,000万股），募集资金金额不超过100,000万元人民币（含100,000万元人民币）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法

规、规章和政策禁止者除外)；

5、本次发行股票发行方式：本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定和具体情况协商确定。

6、本次发行股票向公司原股东配售的安排：本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体 A 股股东优先配售。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。

7、本次发行股票定价方式和发行价格：本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。

8、本次发行股票募集资金用途：

本次募集资金将用于以下用途：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	建设期
1	集成电路封装测试二期扩建工程技术改造项目	60,000	50,000	两年
2	集成电路封装测试三期工程技术改造项目	60,000	50,000	两年
	合计	120,000	100,000	

上述两个项目共需资金 120,000 万元，公司拟通过申请公开发行 A 股股票募集资金。募集资金不足部分，公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述两个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的产品线投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

9、关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：本次增发完成后，公

司新老股东将共享本次增发完成前的滚存未分配利润。

10、本次增发股票上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市。

11、本次增发决议的有效期：本次增发的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

四、本次发行是否构成关联交易

公司本次发行募集资金不构成关联交易。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次公开发行前，本公司控股东南通华达微电子集团有限公司持有公司14,999.40万股，持股比例为43.21%。

根据发行方案，本次公开发行股票数量的上限为10,000万股，若按上限计算，并假设南通华达微电子集团有限公司放弃优先配售，则本次公开发行后南通华达微电子集团有限公司持股比例下降为33.55%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次公开发行的审批程序

本次公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过；

本次公开发行尚需取得中国证监会的核准。

第二节 募投项目可行性研究分析

为满足公司发展所需资金，提高公司抗风险能力和竞争能力，促进公司健康持续快速发展，公司拟申请公开发行A股股票不超过10,000万股，募集资金不超过100,000万元人民币。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次募集资金拟用于以下两个项目：集成电路封装测试二期扩建工程技术改造项目（以下简称“二期扩建项目”）和集成电路封装测试三期工程技术改造项目（以下简称“三期项目”）。

一、项目基本情况

（一）二期扩建项目

1、建设内容：新增建筑面积 14,256 平方米，新增各类生产设备共计 744 台套，形成年封装测试 QFP/LQFP 系列、BGA/LGA 系列、QFN 系列、BUMP、NewWLP 产品共计 246,000 万块的生产能力。

2、建设地点：南通市崇川开发区崇川路 288 号（南通富士通微电子股份有限公司内）。

3、项目总投资：60,000 万元人民币

其中：固定资产投资 55,300 万元人民币（含外汇 7,355 万美元），铺底流动资金投入 4700 万元人民币

4、项目建设期：两年

（二）三期项目

1、建设内容：新增建筑面积 26,732 平方米，其中生产用厂房 24,708 平方米，新增各类生产设备共计 591 台套，形成年封装测试 DFN 系列、DPAK AL 系列、SOT 系列、TOHC AL、TSSOP 系列产品共计 354,000 万块的生产能力。

2、建设地点：南通市崇川开发区崇川路 289 号（南通富士通微电子股份有限公司内）。

3、项目总投资：60,000 万元人民币

其中：固定资产投资 55,000 万元人民币（含外汇 6,000 万美元），铺底流动资金投入 5,000 万元人民币

4、项目建设期：两年

二、项目批文

二期扩建项目和三期项目的可行性研究报告由中国电子工程设计院承担设计，项目立项和环评批复文件正在办理中。

三、项目主要经济技术指标

			二期扩建项目	三期项目
序号	指标名称	单位	数量	数量
1	生产能力	万块/年	246,000.00	354,000.00
2	主要工艺设备、仪器	台（套）	744.00	591.00
3	总投资	万元	60,000	60,000
	其中：固定资产投资	万元	55,300	55,000
	其中：建设期利息	万元	-	-
	其中：含外汇	万美元	7,355	6,000
	流动资金	万元	4,700	5,000
4	正常年销售收入	万元	116,700.00	75,000.00
5	利税总额	万元	11,200.00	11,280.00
6	税后利润	万元	9,760.00	9,800.00
7	销售利润率		8.36%	13.13%
8	投资利润率		16.26%	16.35%
9	投资回收期（税后静态）（含两年建设期）	年	4.50	4.65
10	投资回收期（动态）（含两年建设期）	年	5.60	5.80
11	内部收益率（税后）		13.80%	12.80%

12	平均盈亏平衡点		73.24%	68.58%
----	---------	--	--------	--------

四、项目可行性和必要性分析

随着电子技术的飞速发展，电子产品正朝着微型化、轻便化、多功能化、高集成化和高可靠性方向发展，半导体器件与集成电路的封装也朝着多引脚、细间距、多芯片系统级的封装方向迈进。先进高新技术的发展程度，是衡量一个国家竞争力的标准之一。高新技术电子产品的发展和普及，必须要由先进的芯片制造技术和先进的低成本的封装技术作保障，否则就无法实现。从某种角度讲，没有自主研发的先进封装技术，就没有完全意义上的自主创新的高新技术电子产品。我国 3G 手机、高清电视、移动电视技术及产品的发展以及潜在的强劲市场需求，对芯片设计、制造及封装提出了更高的要求。随着国内芯片设计、制造能力的提升，芯片技术由 0.18、0.13 微米发展到 90 纳米甚至 65 纳米，国内封装企业必须发展与之匹配的先进封装工艺技术，以满足消费电子产品对集成电路封装产品小型化、多功能、高密度、高可靠和低成本的要求。

国内封装业现有技术水平与能力已成为我国集成电路产业发展的瓶颈，严重制约了整个集成电路制造产业的快速发展。如果国内封装企业不能在 BGA、CSP、FC 和 WLP 等先进封装技术上迎头赶上、取得突破，那么，高端封装领域将始终被国外厂商垄断，我国的本土企业将只能在低端封装领域进行低价竞争，我国的集成电路制造产业的发展也将徘徊不前。

本公司二期扩建项目和三期项目的实施顺应了我国集成电路制造产业的发展需要，顺应了我国高新技术产品整体赶超世界一流的需要，顺应了我国国民经济飞速发展的需要。项目实施后，不仅能够为国内 IC 设计企业的自主设计产品提供具有竞争力的先进封装服务，而且，能够为世界知名半导体公司提供更高端、更广泛的先进封装服务。这将有效打破国外厂商在先进封装技术上的垄断，实现国内自主创新产品在设计、制造、封装上的全面本土化，从而有力的提高我国集成电路制造产业整体自主创新能力，增强包括我公司在内的国内集成电路制造企业的核心竞争力和可持续发展能力，推动我国由集成电路制造大国向制造强国的转变。

公司作为国内集成电路封装测试行业的领军企业，有义务也有必要充分利用

以上这些有利条件，共同推进我国半导体封装测试及整个集成电路产业可持续的发展。从区域位置上来讲，公司地处集成电路制造链集中的长江三角洲地区，与上海、苏州隔江相望，随着 08 年苏通大桥的建成通车，南通已融入上海一小时经济圈。公司按“中国第一、世界一流”发展目标，在封装测试基地一、二期厂房已全面竣工并投入使用的情况下，根据发展需要又新增了工业用地 105 亩，为本项目的实施提供了必要条件。从地区发展来看，公司已被列为南通市首批重点培育的 18 家大企业（集团）之一，系该市重点扶持的产业之一。

本项目实施符合国家产业政策，符合国务院颁布的《产业结构调整指导目录》（2007 年本）中鼓励类（二十四—21 条目）、工信部今年 4 月份正式发布的《电子信息产业调整和振兴规划》及南通市《“十一五”信息产业发展规划》，同时通过项目的实施可带动集成电路设计、芯片制造、引线框架、环氧树脂等上下游产业同步发展，将为社会提供 3000 多个就业岗位，对促进社会发展和维持社会稳定具有积极的意义。

通过上述两个项目的实施，年新增销售收入 191,700 万元，实现利润 19,560 万元，使公司现有资源得到充分应用，保证固定资产的保值增值。

综上所述，本项目的实施是合理可行的。

五、募集资金运用计划

本次募集资金将用于以下用途：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	建设期
1	集成电路封装测试二期扩建工程技术改造项目	60,000	50,000	两年
2	集成电路封装测试三期工程技术改造项目	60,000	50,000	两年
	合计	120,000	100,000	

上述两个项目共需资金 120,000 万元，公司拟通过申请公开发行 A 股股票募集资金。募集资金不足部分，公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述两个项目募集资金的投

入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的产品线投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

第三节 本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次发行所募集资金将全部投资于二期扩建项目和三期项目。上述两个项目的实施顺应了我国集成电路制造产业的发展需要，顺应了我国高新技术产品整体赶超世界一流的需要，顺应了我国国民经济飞速发展的需要。项目实施后，不仅能够为国内 IC 设计企业的自主设计产品提供具有竞争力的先进封装服务，而且，能够为世界知名半导体公司提供更高端、更广泛的先进封装服务。

本次募集资金投资项目投产后，公司产品档次、主营业务收入、资产规模与净利润均大幅提升。对于公司成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商具有重要推动意义。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日